

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-025

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于为子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 3 月 19 日、2025 年 4 月 11 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议以及 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2025 年度日常经营及业务发展所需，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 110 亿元（或等值外币）的担保额度。

公司于 2026 年 3 月 2 日、2026 年 3 月 19 日分别召开了第三届董事会第十六次会议、2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司 2025 年度新增对子公司担保额度的议案》，在上述 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度基础上，公司新增对子公司提供不超过 40.55 亿元人民币或其他等值币种的担保额度。综上，公司 2025 年度对子公司担保总额度为人民币 150.55 亿元。其中经审议通过的公司为子公司上海慧忆半导体有限公司（以下简称“慧忆半导体”）提供担保额度的具体情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	慧忆半导体	100%	66.21%	12.50	19.33%	否

注：

- 1、表格中所提及最近一期经审计数据系截止至 2024 年 12 月 31 日的经审计数据；
- 2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。

具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 21 日、2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）、《关于公司 2025 年度新增对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会以及 2026 年第一次临时股东会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。

二、对外担保事项进展

为进一步推进公司购买 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda.（以下简称“Zilia Eletrônicos”）剩余少数股东持有的 19%股权（以下简称“本次交易”），公司全资子公司慧忆半导体作为本次交易的出资实体，拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“浦发银行”）申请并购贷款。

公司对上述并购贷款业务提供连带责任保证担保，并与浦发银行签署了《最高额保证合同》，保证合同中被担保的最高债权额为不超过等值人民币 122,148 万元，被担保债权包括慧忆半导体在自 2026 年 3 月 23 日至 2027 年 3 月 22 日止的期间内与浦发银行办理各类融资业务所对应的债权，以及慧忆半导体与浦发银行于 2023 年 11 月 27 日签署的金额为 94,500 万元的《并购贷款合同》（相关内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2023-093））。

公司全资子公司上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）拟以其自身持有的慧忆半导体 100%股权为上述并购贷款业务提供质押担保，并与浦发银行签署了《权利最高额质押合同》。本次股权质押担保事项已经上海江波龙存储内部审批程序审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议批准。

本次提供担保后，公司为慧忆半导体提供的担保余额的具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度预计(亿元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	本次担保前对被担保方的担保余额(亿元)	本次担保后对被担保方的担保余额(亿元)	剩余可用担保额度(亿元)	是否关联担保
公司	慧忆半导体	100%	66.21%	12.50	19.33%	9.45	12.21	0.29	否

注：

- 1、表格中所提及最近一期经审计数据系截止至 2024 年 12 月 31 日的经审计数据；
- 2、表格中所提及最近一期资产负债率为被担保方最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据中的孰高值。

三、被担保人基本情况

企业名称	上海慧忆半导体有限公司		
成立时间	2020 年 12 月 3 日		
注册资本	80,000.0000 万元人民币		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼		
法定代表人	王景阳		
主营业务	一般项目:从事半导体科技、电子科技、集成电路科技、数字技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;集成电路芯片设计及服务;电子产品销售;集成电路销售;电子元器件零售;电子元器件批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	出资比例
	上海江波龙存储技术有限公司	80,000.0000	100.00%
	合计	80,000.0000	100.00%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司		
是否属于失信被执行人	否		

最近一年又一期主要财务数据：

主要财务数据 (单位：万元)	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月
资产总额	172,843.60	169,607.86
负债总额	114,444.33	109,752.59
其中：银行贷款总额	70,239.81	65,340.82
流动负债总额	114,444.33	109,752.59

或有事项涉及的总额	-	-
净资产	58,399.27	59,855.28
营业收入	-	-
利润总额	-1,456.00	-2,558.43
净利润	-1,456.00	-2,558.43

四、担保协议的主要内容

(一) 《最高额保证合同》的主要内容

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
- 2、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
- 3、债务人：上海慧忆半导体有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证

保证人确认，当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，债权人均有权先要求本合同项下任一保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。

5、被担保主债权：债权人在自 2026 年 3 月 23 日至 2027 年 3 月 22 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 122,148 万元（大写：壹拾贰亿贰仟壹佰肆拾捌万元整）为限。

6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

(二) 《权利最高额质押合同》的主要内容

1、质权人（债权人）：上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行

2、出质人：上海江波龙存储技术有限公司

3、债务人：上海慧忆半导体有限公司

4、质押财产：上海江波龙存储持有的慧忆半导体 100%股权

《权利最高额质押合同》项下质押效力除及于质押财产本身外，还应及于质押财产的从物、从权利、孳息及其代位物。

出质人确认，质权人对质押财产有第一顺位的优先受偿权。当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论质权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，质权人均有权先要求出质人在本合同约定的担保范围内承担担保责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任。

5、被担保主债权：债权人在自 2026 年 3 月 23 日至 2027 年 3 月 22 日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”)，以及双方约定的在先债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 122,148 万元（大写：壹拾贰亿贰仟壹佰肆拾捌万元整）为限。

6、担保范围：除上述主债权外，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、保管担保财产的费用、以及质权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

五、董事会意见

董事会认为，公司及子公司为下属全资子公司提供担保，有利于拓宽下属全资子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属全资子公司的生产经营需要。虽然慧忆半导体未能提供反担保，但公司对其有控制权，风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保总额度为人民币 150.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 232.80%。公司仅存在对合并报表

范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 74.40 亿元（涉及外币的，则按照国家外汇管理局网站公布的 2026 年 3 月 24 日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 115.51%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司 2024 年年度股东大会决议、2026 年第一次临时股东会决议；
- 3、公司与浦发银行签署的《最高额保证合同》；
- 4、上海江波龙存储与浦发银行签署的《权利最高额质押合同》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日